



KC ČIP.SI
SLOVENSKI KOMPETENČNI
CENTER ZA ČIPE

NOVIČNIK

Petek, 17. julij 2026

Pozdravljeni,

tudi v poletnih mesecih se aktivnosti na področju čipov in polprevodniških tehnologij niso ustavile. V KC Čip.si smo vam pripravili pregled nekaterih aktualnih novic, dogodkov, izobraževanj in drugih zanimivosti s področja čipov in polprevodniških tehnologij.

Dogodki:

- Webinar: [Philippine Semiconductor and Electronics Industry \(PSEI\) Roadmap, CHIPDIPLO](#)
29. julij, 2026, 8:30 – 9:30, on-line
Spletni seminar bo predstavil razvojni načrt filipinske industrije polprevodnikov in elektronike (PSEI), katerega cilj je do leta 2030 povečati izvoz v teh sektorjih na skupno 110 milijard USD. Udeleženci bodo imeli priložnost spoznati filipinski ekosistem polprevodnikov, industrijsko strategijo države ter poslovne in investicijske priložnosti za evropska podjetja, vlagatelje in oblikovalce politik.
Za dogodek se je potrebno registrirati – [tukaj](#).
- Webinar: [Chips Think Tank Webinar#6: Building the Materials Platform for the Future of Integrated Photonics](#)
30. julij, 2026, 12:00 – 13:00 h, on-line
Integrirana fotonika se razvija z uporabo naprednih materialov in procesov, ki omogočajo hitrejše, energijsko učinkovitejše fotonske komponente za AI, kvantne tehnologije, telekomunikacije in senzoriko. Webinar bo obravnaval tudi izzive prenosa teh tehnologij iz raziskav v industrijo.
Registracij za dogodek – [tukaj](#).
- Izobraževanje: [ASIC Design Introduction: From Concept to Silicon](#)
24.-28. avgust, 2026, Leuven, Belgija
Tečaj ponuja celovit uvod v načrtovanje in razvoj integriranih vezij (ASIC), vključno z osnovami digitalnega in analognega načrtovanja, pakiranja, testiranja, integracije čipletov ter izzivov, povezanih z intelektualno lastnino. Program je namenjen inženirjem in drugim tehnično usmerjenim strokovnjakom, ki želijo pridobiti ali poglobiti znanje s področja mikroelektronike.
Program izobraževanj si ogledate lahko na [povezavi](#).
Cena izobraževanja: 750 €
Prijave za izobraževanja se zbirajo [tukaj](#).
- Razpis: [Eurostars Call 11 for projects – deadline September 2026](#)
Program za financiranje mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki jih vodi inovativno MSP v sodelovanju s podjetji, univerzami in raziskovalnimi

organizacijami. Cilj je razvoj tržno uporabnih inovacij.

Za slovenske partnerje Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije sofinancira:

- mikro in mala podjetja: do 60 % upravičenih stroškov,
- srednje velika podjetja: do 50 %,
- velika podjetja: do 40 %.

Univerze in javne raziskovalne organizacije trenutno niso upravičene do neposrednega financiranja, lahko pa sodelujejo kot podizvajalci slovenskih podjetij ali svoje stroške krijejo same. Slovenski prijavitelji morajo poleg mednarodne prijave oddati tudi nacionalno prijavo.

Več informacij lahko zainteresirani pridobite na pri [Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino](#).

Prijavni rok: **10. september, 2026, do 14:00 CET**

Razpisi:

- Razpis: **[Eurostars Call 11 for projects – deadline September 2026](#)**

Program za financiranje mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki jih vodi inovativno MSP v sodelovanju s podjetji, univerzami in raziskovalnimi organizacijami. Cilj je razvoj tržno uporabnih inovacij.

Za slovenske partnerje Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije sofinancira:

- mikro in mala podjetja: do 60 % upravičenih stroškov,
- srednje velika podjetja: do 50 %,
- velika podjetja: do 40 %.

Univerze in javne raziskovalne organizacije trenutno niso upravičene do neposrednega financiranja, lahko pa sodelujejo kot podizvajalci slovenskih podjetij ali svoje stroške krijejo same. Slovenski prijavitelji morajo poleg mednarodne prijave oddati tudi nacionalno prijavo.

Več informacij lahko zainteresirani pridobite na pri [Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino](#).

Prijavni rok: **10. september, 2026, do 14:00 CET**

Novice:

- **[Chips Act 2.0: a shift towards demand for European chips](#)**

Chips Act 2.0 poudarja povpraševanje po evropskih čipih, sodelovanje med deležniki ter hitrejši prenos inovacij na trg. Za uspeh evropske polprevodniške industrije sta ključna povezovanje celotne vrednostne verige in krepitev tehnološke odpornosti Evrope.

- **[Engineers shrink powerful terahertz systems onto a single semiconductor chip](#)**

Raziskovalci z UCLA so razvili polprevodniški čip, ki na eni sami platformi združuje generiranje, zaznavanje, modulacijo in ojačanje teraherčnih signalov. Ta preboj omogoča bistveno manjše, cenejše in lažje množično izdelane teraherčne sisteme (omogočajo široke pasovne širine), ki bi lahko pospešili razvoj brezžičnih komunikacij naslednje generacije (6G), naprednega slikanja in senzorike.

- **[Can Fine-Pitch Hybrid Bonding Go High Volume?](#)**

Hibridno spajanje omogoča naprednejše povezovanje čipov, vendar množično proizvodnjo še omejujejo izzivi pri poravnavi, čistosti in zanesljivosti procesa.

- **New method improves control over organic semiconductor doping for flexible electronics**

Raziskovalci so razvili novo metodo za natančnejše dopiranje organskih polprevodnikov z uporabo ustreznega topila. To omogoča bolj zmožljivo in stabilno fleksibilno elektroniko, kot so nosljivi senzorji, upogljivi zasloni in naprave za zajem energije.

- **Atom-thin coating tackles key bottleneck in chip miniaturization**

Raziskovalci NUS in Applied Materials so razvili atomsko tanko prevleko (WS_2), ki izboljša povezave med tranzistorji in omogoča nadaljnje pomanjševanje čipov. Nova plast je bistveno tanjša od današnjih rešitev, hkrati pa povečuje hitrost, učinkovitost in zanesljivost prihodnjih polprevodniških vezij.

Želimo vam uspešen zaključek tedna,
vaš KC Čip.si



Slovenski kompetenčni center za čipe in polprevodniške tehnologije

KC Čip.si - glavna pisarna

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tržaška cesta 25, Ljubljana

E-pošta: office@cc-chip.si

Tel.: 01 476 88 50

Spletna stran: <https://cc-chip.si/>



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Projekt CC Chip.si (št. 101217674) je sofinanciran s strani
Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru
programa Digital Europe.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavili na prejemanje novic KC Čip.si ali izrazili interes za obveščanje o naših dejavnostih.

Če novic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

